

<<微电子封装手册>>

图书基本信息

书名：<<微电子封装手册>>

13位ISBN编号：9787505345775

10位ISBN编号：750534577X

出版时间：2001-8

出版时间：电子工业出版社

作者：(美)Rao R.Tummala Eugene J.Rymaszewski Alan G.Klopfenstein

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<微电子封装手册>>

### 内容概要

本书系由国际上最著名的来自不同国家和公司从事微电子封装的74位专家集体编写而成。全书分三大部分18章。

第1部分是封装技术的驱动力，共6章，包括微电子封装概论、封装布线和端子、封装电设计、热设计、可靠性及封装制造管理等一些有关封装的基本知识；第2部分是半导体封装，共7章，包括芯片与封装的互联陶瓷封装、塑料封装、电子封装中的聚合物材料产、薄膜封装、封装电测试、封装的密封和包封；第3部分是系统或板级封装

<<微电子封装手册>>

书籍目录

作者:(美)Rao R.Tummala等编 中国电子学会电子封装专业委员会, 电子封装丛书

<<微电子封装手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>